



高耐熱

UV硬化型シリコーン

UV硬化タイプと特長

硬化タイプ	特長
ラジカル反応	速硬化
白金付加反応	遅延硬化
ラジカル+縮合反応	暗部硬化

●電子部品の固定

適用製品：UV硬化型シリコーンシール材
 硬化タイプ：ラジカル反応／白金付加反応
 ラジカル+縮合反応



デジタル眼レフレズ

用途例

●タッチパネルの貼り合わせ

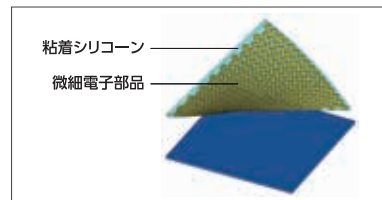
適用製品：オプティカルボンディング用シリコーン
 硬化タイプ：白金付加反応



カーナビのタッチパネル

●μ-LED搬送用シリコーンパッド

適用製品：UV硬化型粘着シリコーン
 硬化タイプ：ラジカル反応



ディスプレイ



高耐熱

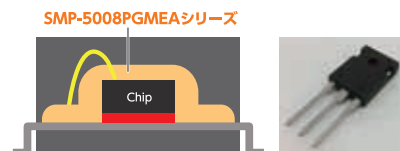
ポリイミドシリコーンプライマー SMP-5008PGMEAシリーズ

特長

- ・エポキシモールド樹脂や金属フレームとの接着性良好。
- ・粘度違いの製品ラインアップで、さまざまなパッケージ形態に対応。
- ・硬化後は弾性塗膜となり、応力緩和層としても効果を発揮。

用途例

- ・パワー系・ロジック系IC、コンデンサ、センサー、サーミスタなど



使用方法

- ・ジェットディスペンス、スプレー塗布、ディッピングなど



リードフレームとエポキシモールド樹脂の接着性評価

- ・吸湿リフロー試験 (MS L-1) :
 85°C / 85%RH×168h⇒リフロープログラムを計3回実施
- ・パッケージ：TO-247 (基板:AMB Cu-SiN、チップ:SiC-SBD)

条件	試験前			試験後	
	SAT観察結果			SAT観察結果	SEM断面観察結果
SMP-5008 PGMEA 処理済					
未処理					

